開示の要約

研磨ヘッドシステムおよび研磨方法

本発明は、ウェーハなどの基板の研磨レート、特にエッジ部での研磨レートを精密に制御できる研磨ヘッドシステムが開示される。研磨ヘッドシステムは、研磨ヘッドと、ヘッドシャフトと、ヘッド回転機構と、マルチパスロータリージョイントと、流体供給ラインと、圧力レギュレータを備え、研磨ヘッドは、基板押圧面と、リテーナリングと、リテーナリングの周方向に沿って配列された複数の圧力室を有し、ヘッドシャフトは、複数の圧力室にそれぞれ連通する複数のシャフト流路を有し、マルチパスロータリージョイントは、ヘッドシャフトが一回転するたびに、流体供給ラインを、複数のシャフト流路に順次連通させるように構成されている。

図２